N7000-2HT LAMINATE N7000-3 PREPREG



Toughened Polyimide

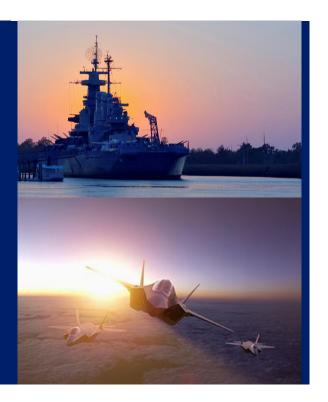
Laminate & Prepreg

특장점

- Polyimide Resin Chemistry
- 우수한 열 안정성 및 신뢰성
- 내고온성 및 내화학성
- 가혹한 환경에서 사용할 수 있도록 설계

적용분야

- Backplane
- 미세회로, SMT 및 BGA 다층
- Direct Chip Attach
- Underhood Automotive
- Burn-in Boards



N7000-2 HT laminate 및 N7000-3 prepreg는 고신뢰성 다층 PCB를 위한 강화 Polyimide 소재입니다. 이와 같이 복합된 resin 시스템은 기하학적 다층 구조와 극도의 신뢰성이 요구되는 다양한 애플리케이션을 위한 열성능 및 가공성을 제공하는 우수한 소재입니다.

Polyimide Resin Chemistry

- 우수한 열 안정성 및 신뢰성
- 강화된 Resin 시스템
- 내고온성

우수한 신뢰성 및 성능

- 다수의 고온 공정에 견딤
- DSC Tg 260°C
- T-260 120분 초과
- 낮은 Z축 열팽창계수(CTE)
- 가혹한 조건에서 사용하기 위한 설계

신뢰성이 높은 도금홀

• 우수한 치수 안정성을 제공하는 낮은 Z축 열팽창계수(CTE) 및 강화 Polyimide

신뢰할 수 있는 가공

- 기존의 Polyimide 시스템보다 개선된 균열 저항성
- 기존의 다른 Polyimide 시스템보다 줄어든 경화 시간

IPC-4101/40, /41 및 /42 사양 충족

N7000-2HT 라미네이트는 UL 94 V-0 난연 등급을, N7000-3 프리프레그는 UL 94 V-1 난연 등급을 받았습니다. 이전 GIJ 및 GIL 사양을 준수합니다.

UL 파일 번호: E36295



특성	조건	대표값	단위	시험방법
전기적 특성				
Dielectric Constant	@ 2.5 GHz	3.5		
	@ 10 GHz	3.5		IDC TM CEO 2 F F F
Dissipation Factor	@ 2.5 GHz	0.009		IPC-TM-650.2.5.5.5
	@ 10 GHz	0.009		
Volume Resistivity	C - 96 / 35 / 90	10 ⁷	MΩ - cm	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E - 24 / 125	10 ⁷		
Surface Resistivity	C - 96 / 35 / 90	10 ⁷	ΜΩ	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E - 24 / 125	10 ⁷		
Electric Strength		4.7x10 ⁴ (1200)	V/mm (V/mil)	IPC-TM-650.2.5.6.2
열 특성				
*Glass Transition Temperature (Tg)	DSC(°C)	260	°C	IPC-TM-650.2.4.25c
Degradation Temperature (TGA)	Degradation Temp (TGA)	376	°C	IPC-TM-650.2.4.24.6
	(5% wt. loss)	370		
T-260	Time to delamination @	120+	minutes	IPC-TM-650.2.4.24.1
The local site	260°C	0.45	14// 1/	A CTN 4 F4 4 C4
Thermal Conductivity		0.45	W/mK	ASTM E1461
기계적 특성				
Peel Strength	1 oz (35μ) Cu	1.31 (7.5)	N/mm (lbf/inch)	IPC-TM-650.2.4.8
V / V CTF	After Solder Float	0.742	10.5	IDC TN C50 2 4 44
X / Y CTE	-40°C to + 125°C	9 / 12	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.41
Z Axis Expansion (43% RC)	50°C to 260°C	< 2.5	%	IPC-TM-650.2.4.24
Young's Modulus (X / Y)		21.1 / 22.2	GN/m ²	ASTM D3039
		(3.1 / 3.3)	(psi x 10 ⁶)	
Poisson's Ratios (X / Y)		0.146 / 0.153		
화학적 / 물리적 특성				
Moisture Absorption		0.35	wt. %	IPC-TM-650.2.6.2.1

^{*} DMA는 Tg를 측정할 때 가장 선호되는 방법입니다. 다른 방법들은 DMA만큼 정확하지 않을 수 있습니다.

- 제공된 모든 테스트 데이터는 대표값이며, 제품 사양값으로 사용할 수 없습니다. 중요 사양 공차에 대한 검토는 회사 담당자에게 직접 문의하십시오.
- N7000-2HT 및 N7000-3은 2 mil (0.05 mm) 이상 두께의 laminate로 생산됩니다.
- N7000-2HT 및 N7000-3은 가장 일반적인 패널 크기로 제공됩니다.
- 극저조도동박, RTFOIL®을 포함한 동박무게 및 유리섬유 종류 등 기타구조에 대해서는 AGC에 문의하십시오.
- Resistor foils 제조업체는 Resistor layer이 포함된 Copper foil에 대한 보증과, Copper foil의 성능 및 작업 가능성을 보 장합니다. 당사는 Resistor layer의 가공이나 최종 제품의 성능 및 가공성에 대해 책임을 지지 않습니다.

